

# クリップ端子仕様

## 1. 材質

鉄 SPCC  
リン青銅 C5191-1/2H

## 2. 表面処理

めっきラインナップ

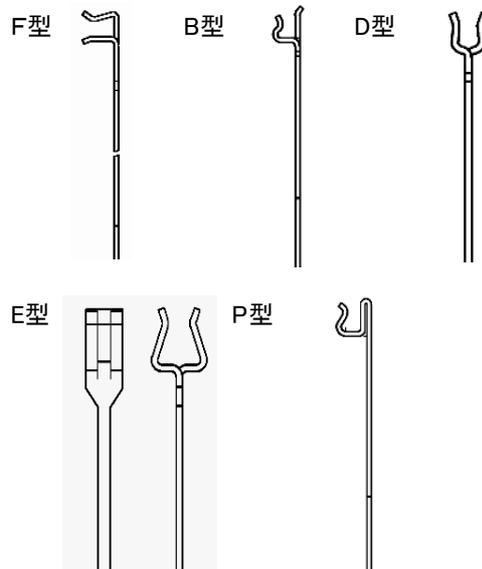
		下地	
		Niめっき	Cuめっき
表面	半光沢Sn	○	○
	無光沢Sn	○	○
	光沢Sn-Cu	○	○

めっき厚規格

下地	Niめっき	0.5~2.0 $\mu$ m
	Cuめっき	1.0~3.0 $\mu$ m

表面	半光沢Sn	3.0~8.0 $\mu$ m
	無光沢Sn	
	光沢Sn-Cu	

## 3. クリップ形状



## 4. 備考

- ・ホームページに記載させて頂いているハイブリット基盤用(HIC)端子は、弊社ラインナップの代表例になります。
- ・ホームページに記載させて頂いているハイブリット基盤用(HIC)端子は、弊社より、ご提案させて頂きます。
- ・ご要望に合わせて、カスタム金型、既存金型改造のご対応もできます。